

# 强一股份：持续研发创新 力争成为具有全球竞争力国产探针卡厂商

## ——强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

### 出席嘉宾

强一半导体(苏州)股份有限公司董事、副总经理  
强一半导体(苏州)股份有限公司副总经理  
强一半导体(苏州)股份有限公司董事会秘书

于海超先生  
黄海军先生  
张子涵女士

中信建投证券股份有限公司保荐代表人  
中信建投证券股份有限公司保荐代表人

郭家兴先生  
张宇辰先生

### 强一半导体(苏州)股份有限公司董事、副总经理于海超先生致辞



尊敬的各位投资者朋友和各位关心强一股份的网友：

大家好！非常感谢大家参与强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。借此机会，向多年来关心、支持公司发展的各位朋友表示感谢！同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！我们希望，通过此次网上交流活动，充分、客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解强一股份。

公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研究、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡厂商，打破了境外厂商在MEMS探

针卡领域的垄断。探针卡是一种应用于半导体生产过程晶圆测试阶段的“消耗型”硬件，是半导体产业的基础支撑元件。长期以来，探针卡行业被境外厂商所主导，国产化发展潜力巨大。随着公司2D MEMS探针卡实现从探针卡的自主研发制造，公司与境外厂商进行直接竞争，并实现了市场份额的不断提升。根据公开信息，2023年、2024年，强一股份分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。

强一股份凭借深入的需求理解、扎实的技术实力、丰富的交付经验以及可靠的规模化生产能力，得到了客户的高度认可，较为全面地覆盖境内半导体产业链的主要参与者。公司的典型客户包括兆易创新、豪威集团、地平线、摩尔线程、龙芯中科、紫光国微、复旦微电子等芯片设计厂商，华虹集团、中芯集成、宁波等晶圆代工厂商以及长电科技、盛合晶微、伟测科技等封装测试厂商。

未来，公司将持续加大研发投入，以满足不同客户各类晶圆测试需求为目标，不断提升产品性能、扩充产品种类，深化既有客户服务能力的同时积极拓展境内外新客户，力争成为具有全球竞争力的国产探针卡厂商，为保障我国半导体产品的质量、可靠性以及制造效率作出更大贡献。

我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友们所关心的问题，让大家更加了解和认同强一股份。同时，也希望公司在迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持！最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家！

### 中信建投证券股份有限公司保荐代表人张宇辰先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好！作为本次发行的保荐人和主承销商，我谨代表中信建投证券股份有限公司，对今天参加强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！

强一股份自成立以来深耕探针卡业务多年，逐步丰富产品及服务体系，业务涵盖悬臂探针卡、垂直探针卡以及各类MEMS探针卡。凭借技术创新、产品优化、深度服务，公司有效协助客户降低制造成本，提高产品

良率。强一股份以市场及客户需求为导向，以自主创新为依托，持续保持较高研发投入、加强技术创新，形成了自身的核心竞争力。目前，公司掌握24项核心技术，取得了授权专利182项，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商。与此同时，公司拥有多条制造MEMS探针的全流程产线，配备了先进的光刻、激光、蚀刻、电化学沉积、薄膜沉积、研磨、检测等探针制造关键设备。

中信建投非常荣幸能够陪伴并见证强一股份此次A股发行上市的全过程，为公司的发展、为我国探针卡行业的发展助力。我们相信，强一股份在登陆A股资本市场后，将借助资本市场平台，钻研技术、扩大产能，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，以优良的业绩回报社会和广大投资者。

中信建投也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们也真诚地希望，通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分地了解强一股份，把握机会，做好价值投资，共同分享优秀企业的发展成果。

最后，我谨代表中信建投，预祝强一股份本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

### 强一半导体(苏州)股份有限公司董事会秘书张子涵女士致结束语



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票的路演即将进入尾声。在此，我谨代表强一股份，衷心感谢大家的热情参与和宝贵意见！同时，也感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台，感谢保荐机构中信

建投证券以及所有中介机构团队一路以来的辛勤付出，谢谢你们！

很荣幸今天能和各位关心强一股份的投资者朋友深入交流公司的核心技术、经营情况和战略规划，希望能够帮助大家更加了解公司的投资价值。我们也深切地感受到大家对强一股份的关注、支持与期待，真诚地欢迎大家今后继续通过各种方式与我们保持沟通与交流。

强一股份的成长，源于对半导体国产化发展的坚定信念，源于对技术创新的持续投入。未来，我们将继续以“打破境外垄断，实现探针卡自主可控”为使命，在全球半导体产业浪潮中把握机遇，不仅是用更好的经营业绩回报每一位股东，更是要与中国半导体产业同频共振，成为产业链中不可或缺的实力力量。

最后，再次感谢大家的陪伴与信任，希望我们携手共进，创造和分享属于强一股份和全体股东更加美好的未来！谢谢大家！



### 经营篇

问：公司的主营业务是什么？

于海超：公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研究、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商，打破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断。根据公开信息，2023年、2024年，公司分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。

问：公司的核心技术有哪些？

黄海军：公司的核心技术包括：1) 高陡直光刻胶膜制造技术；2) 钎合金电学沉积技术；3) 表面平坦化技术；4) 探针针硬金镀制技术；5) 高精度激光蚀刻技术等。公司研发的各项核心技术主要应用于公司已量产或即将量产的各类产品中，为公司经营规模的不断增长起到了积极贡献。

问：公司拥有多少商标？

黄海军：截至2025年9月30日，公司及子公司共拥有4项注册商标。

问：公司拥有多少专利？

黄海军：截至2025年9月30日，公司及子公司拥有授权专利182项，其中境内发明专利72项、境外发明专利6项。

问：公司过往获得的奖项或者荣誉有哪些？

黄海军：公司近年来主要获得的奖项、荣誉或科研平台认定情况包括：国家级专精特新“小巨人”企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、江苏省专精特新中小企业、2024年度苏州市“独角兽”培育企业、2022年度苏州市“独角兽”培育企业、市级企业技术中心等。

问：请介绍公司的客户资源情况。

黄海军：凭借深入的需求理解、扎实的技术实力、丰富的交付经验以及可靠的规模化生产能力，公司产品及服务得到客户认可。近年来，公司单体客户数量合计超过400家，较为全面地覆盖境内芯片设计厂商、晶圆代工厂商、封装测试厂商等多类产业核心参与者。

问：请介绍公司的规模化产线情况。

黄海军：经过多年发展，公司生产体系逐步完善并陆续建立了配备先进研发设备、生产设备的实验室、工厂，拥有从MEMS探针制造到MEMS探针卡制造的完整产线。目前，公司已拥有三条8寸MEMS产线和一条12寸MEMS产线，初步实现公司探针卡核心部件的自主可控。公司拥有专业的管理、研发、工程技术和生产团队，配备专业的生产、研发设备，并建立了百级、千级等无尘工厂，有效提升了产品交付能力，保证了产品的品质。

问：公司的营业收入是多少？

黄海军：2022年至2024年及2025年上半年，公司营业收入分别为25415.71万元、35443.91万元、64136.04万元和37440.21万元，其中2022年至2024年复合增长率为58.85%，保持良好的增长趋势。

问：公司的综合毛利及毛利率是多少？

张子涵：2022年至2024年及2025年上半年，公司毛利分别为10364.74万元、16444.08万元、39546.38万元和25829.78万元，其中主营业务毛利占比分别为93.03%、95.94%、99.26%和99.17%，是公司毛利的主要来源；公司综合毛利率则分别为40.78%、46.39%、61.66%和68.99%，呈现逐步上升趋势。

问：公司的研发费用是多少？

张子涵：2022年至2024年及2025年上半年，公司研发费用分别为4604.11万元、9297.13万元、7853.73万元和6706.25万元，其中2022年至2024年复合增长率为30.61%，占营业收入的比例分别为18.12%、26.23%、12.25%和17.91%。2022年至2024年及2025年上半年，公司累计研发费用为28461.23万元，占累计营业收入的比例为17.52%。

### 发展篇

问：公司未来的战略规划是怎样的？

于海超：未来，公司将持续加大研发投入力度，以满足不同客户各类晶圆测试需求为目标，不断提升产品性能、扩充产品种类，深化既有客户服务能力的同时积极拓展境内外新客户，力争成为具有全球竞争力的国产探针卡厂商。

在半导体产业快速发展以及国产化发展进程

加速背景下，国产探针卡厂商迎来更为广阔的发展空间。未来，公司在MEMS探针卡方面将不断丰富产品的应用领域，进一步提升2D MEMS探针卡的市场份额，并积极推动薄膜探针卡、2.5D/3D MEMS探针卡的大规模量产及交付；在非MEMS探针卡领域，公司将通过强化产品性能、提升服务效率、聚焦龙头客户等方式不断巩固市场竞争力。

问：公司有怎样的短期和长期战略规划？

于海超：短期来看，对于2D MEMS探针卡，公司将立足以手机AP为代表的非存储领域竞争优势，重点布局面向算力GPU、CPU、NPU以及FPGA等领域的高端产品及客户拓展。对于薄膜探针卡，公司产品目前最高测试频率达到67GHz，技术方面力争实现110GHz的突破。对于2.5D MEMS探针卡，重点布局面向HBM领域的产品研制，实现面向高端CIS的大规模出货。

长期来看，公司将不断深入探针卡前沿技术研发，提升产品丰富度、提高产品性能、增强产品品质。产品方面，公司不断引领2D MEMS探针卡方面的技术创新，努力实现薄膜探针卡220GHz的技术攻关，力争实现面向DRAM芯片的3D MEMS探针卡的研制。技术方面，公司努力实现探针卡更高层次的自主可控，对于2D MEMS探针卡，力争实现以玻璃为材料的空间转接基板的生产制造，同时，深耕探针卡材料电镀液自主研制；对于2.5D/3D MEMS探针卡，力争突破MLC的全制程制造能力。

问：公司未来将如何全面布局下游市场，提升不同领域的产品竞争力？

于海超：从应用领域来看，探针卡产品应用于以SoC芯片、CPU、GPU、射频芯片为代表的非存储领域以及以DRAM、NAND Flash为代表的存储领域。2018年至2024年，非存储领域市场规模占比保持在60%至75%之间，存储领域市场规模占比在25%至40%之间。公司主要产品2D MEMS探针卡、薄膜探针卡系面向非存储领域的高端探针卡，主要客户包括国内领先乃至全球知名的芯片设计厂商、晶圆代工厂商及封装测试厂商。同时，公司一直在积极布局存储领域，已经实现面向HBM、NOR Flash的2.5D MEMS探针卡的验证以及面向DRAM、NAND Flash的2.5D MEMS探针卡样卡研制，结合境内市场情况，围绕合肥长鑫、长江存储等客户进行重点拓展。通过本次上市，公司可以巩固在非存储领域的技术优势，实现存储领域的技术突破，扩大2D MEMS探针卡、薄膜探针卡以及2.5D MEMS探针卡的生产制造能力，提升不同领域的产品竞争力。

问：公司的竞争优势有哪些？

黄海军：公司的竞争优势有：1) 技术能力及创新优势；2) 产品国产化优势；3) 客户资源优势；4) 团队及人才优势；5) 规模化产线优势；6) 产业集群及服务优势。

### 行业篇

问：公司所属行业及确定依据是什么？

于海超：根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司属于“C制造业”中的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类(2018)》，公司业务属于“1新一代信息技术产业”中的“1.2电子核心产业”中的“1.2.1新型电子元器件及设备制造”；此外，公司所属行业还是《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的“鼓励类”产业。

问：探针卡行业的发展潜力如何？

于海超：近年来，全球探针卡行业市场规模总体保持较快增长。根据公开信息搜集并整理，2018年至2022年，全球半导体探针卡行业市场规模由16.51亿美元增长至25.41亿美元。受半导体产业整体周期性波动影响，2022年全球半导体探针卡行业市场规模增速放缓，2023年规模收缩至21.09亿美元。但随着半导体产业的景气度回升以及晶圆测试重要性的提升，2024年，全球半导体探针卡行业市场规模达到26.51亿美元，预计2029年将增长至39.72亿美元。

作为全球半导体最重要的市场之一，中国探针卡行业市场潜力巨大。根据公开信息搜集并整理，2018年至2022年，中国探针卡行业市场规模由1.35亿美元增长至2.97亿美元，复合增长率达2183%，接近全球半导体探针卡行业同期复合增长率的两倍。但是，由于不确定性因素增加，叠加

终端应用需求呈现周期性疲软态势，导致2022年、2023年我国探针卡市场规模存在不同程度的下降。随着全球半导体产业的景气度回升以及中国半导体产业的快速发展，2024年，中国半导体探针卡市场规模增长至3.57亿美元，同比增长69.17%。在政策、市场、技术的推动下，中国半导体制造能力和技术有望实现快速追赶，中国半导体探针卡市场规模占全球市场的比例将持续提升。

问：探针卡行业面临的机遇是什么？

于海超：探针卡行业面临的机遇有：1) 国产化发展进程加速释放巨大的市场潜力；2) 国家积极出台产业政策支持行业快速发展；3) 下游牵引及行业技术发展拉动行业需求；4) 我国半导体产业快速增长带动境内产业链协同发展。

问：探针卡行业的国产化发展情况如何？

于海超：一直以来，探针卡行业均由境外厂商主导，多年来的全球前十大探针卡厂商均为境外公司。根据公开信息搜集并整理，2018年以来，全球前十大厂商占据了全球市场份额的80%以上，其中前三大厂商为美国的FormFactor、意大利的Technoprobe以及日本的MJC，合计占据全球超过50%的市场份额。

我国半导体行业整体起步较晚，在芯片设计及晶圆制造环节仍然存在不同程度的进口依赖，导致我国国产探针卡行业发展存在一定滞后。根据公开信息搜集并整理，2024年，我国半导体探针卡市场规模接近全球的15%，但国产探针卡厂商全球市场份额不足5%，国产化发展空间广阔。近年来，半导体产业链安全问题受相关因素的持续影响，有效释放了国产探针卡的需求，探针卡国产化发展进程加速。

问：公司在行业中的市场地位如何？

于海超：根据公开信息搜集并整理以及Yole的数据，2023年、2024年，公司分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业，是境内探针卡市场地位领先的国产厂商，在业务开展过程中公司主要与领先的境外探针卡厂商直接竞争。

### 发行篇

问：公司此次上市的目的是什么？

于海超：公司此次上市的目的为：1) 致力服务国家战略，保障我国半导体产品的供应安全；2) 全面布局下游市场，提升不同领域的产品竞争力；3) 持续增强研发能力，提高产品的自主可控度；4) 不断优化经营质量，为股东实现价值创造。

问：公司本次募投项目有哪些？

郭家兴：经公司2023年第三次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会审议批准，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：南通探针卡研发及生产项目、苏州总部及研发中心建设项目。

问：请介绍“南通探针卡研发及生产项目”的情况。

郭家兴：本项目拟通过新建生产用房及相关配套设施，引进光刻机、电镀设备、匀胶显影机等先进生产设备，进行2D MEMS探针卡、2.5D MEMS探针卡及薄膜探针卡的产能建设。本项目的实施将显著提升公司产能，可以为更多客户提供更为充裕的产品；进一步提升公司市场份额，强化国产化发展能力和实力；有利于公司完善产品体系，增强市场竞争力；有效解决公司产线自动化程度不足的问题，有利于提高规模化生产的效率。

问：请介绍“苏州总部及研发中心建设项目”的情况。

张宇辰：本项目拟通过租赁房屋新增总部办公场所及研发中心，通过搭建专业实验室，购置先进的研发、分析、检测等设备，配置高端仿真及设计软件，吸引行业内高端技术人才，进一步完善公司的研发平台建设，并对“45μm Fine Pitch 2D MEMS垂直探针卡”“50μm Pitch DRAM探针卡”“陶瓷封装基板”“贵金属电镀液”“用于Space Transformer的玻璃基板”“Micro LED Probe Unit”“陶瓷卡盘”“超多针数2D MEMS探针卡”等材料或产品课题进行研究。